

2008年3月期 中間決算説明会

株式会社ディスコ

2007年11月13日
大和コンファレンスホール

「見通し」に関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動等があります。

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当 関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長 溝呂木 斉

3. 質疑応答

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当

関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長

溝呂木 斉

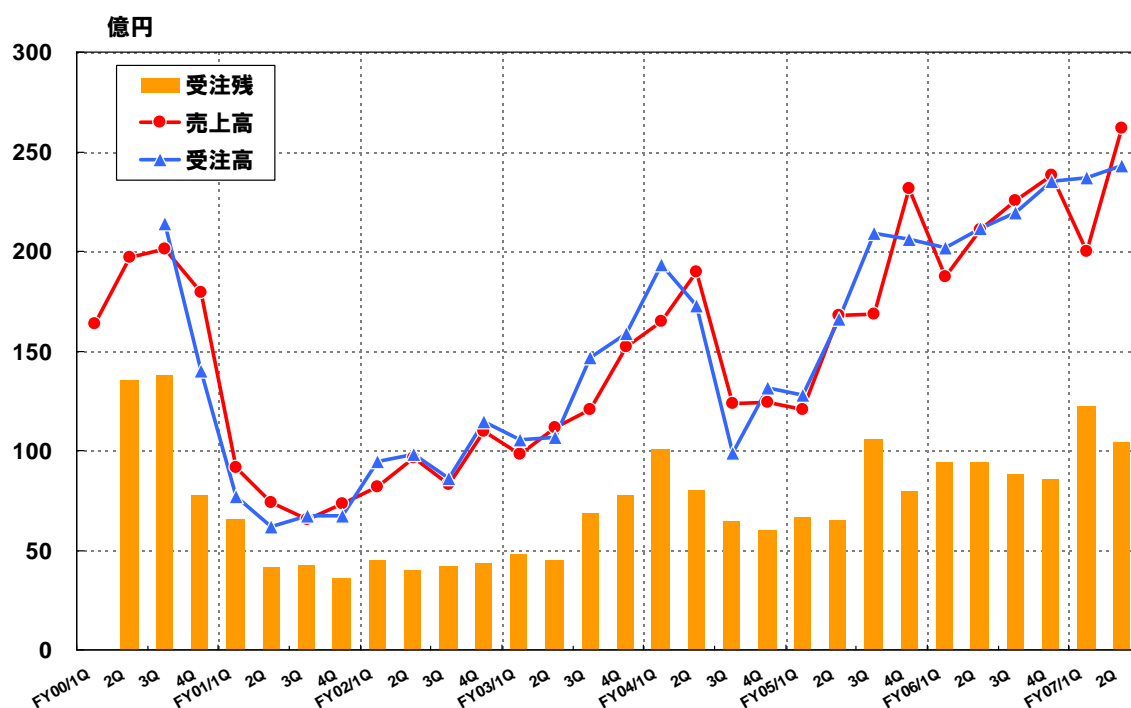
3. 質疑応答

プレゼンテーション

常務取締役 関家圭三

(単位: 億円 四捨五入)	2006年度		2007年度		
	中間期	通期	中間期	前年同期比 (%)	
売上高	398	861	461	15.9%	過去最高の前下期とほぼ同水準
売上総利益	211	440	238	-	
GP率	53.0%	51.1%	51.6%	-1.4pt	
営業利益	95	195	110	15.0%	営業外費用: 為替差損2億円
経常利益	95	196	110	16.0%	
経常利益率	23.9%	22.8%	23.9%	0t	
税引き前利益	92	177	110	-	海外子会社の清算にかかわる繰延べ税金資産の取り崩し5億円
当期純利益	55	109	62	11.6%	
一株あたり利益(円)	163.45	321.22	181.98	-	
受注高	413	868	480	16.2%	過去最高を更新
受注残	94	86	104	-	

- 第一四半期は出遅れていたメモリ関連投資も6月から回復の動きに転じ、第二四半期にも継続した。結果、第二四半期は261億円の売上を達成。上期売上高は過去最高であった前下期463億円にほぼ同水準の461億円の好調な売上。
- GP率は上期で51.6%と前年度通期とほぼ同じレベルの利益率。
前年同期の53%からは減少。その主要因は昨年下半年から連結対象となった子会社のダイチコンポーネンツによるもの。ダイチコンポーネンツは当社単体の事業に比較すると、低採算（赤字ではない）のため、利益寄与が低い分、GP率を1%程度押し下げる要因となった。その影響を除くと全体で52.5%のGP率を達成していることになり、前年同期と比較してもほぼ同じ水準を維持。
- 営業外費用の2億90百万円はほとんどが売掛債権等の為替評価損によるもの。
- 特損のうち、ディスコアブレイシブシステムの持分会社イタリアSEA社に対する貸倒引当金19百万円を計上。これでイタリアSEA社に対する債権は全て引当て。
- 法人税は期初想定りも5億円増額となった。要因としてはイタリアSEA社の売却計画が計画変更になり、9月末時点で具体的なスケジュールが立っていないことから、税効果会計上、会計監査人の指導で5億円の繰延べ税金資産の取り崩し。
この売却計画は期末までには再計画を立て直し完了させる見通し。従って年度内には税効果会計上、再度繰り延べ税資産への繰り入れを行うことができる予定。
- 結果、当期純利益は62億円、前年同期比11.6%増となった。

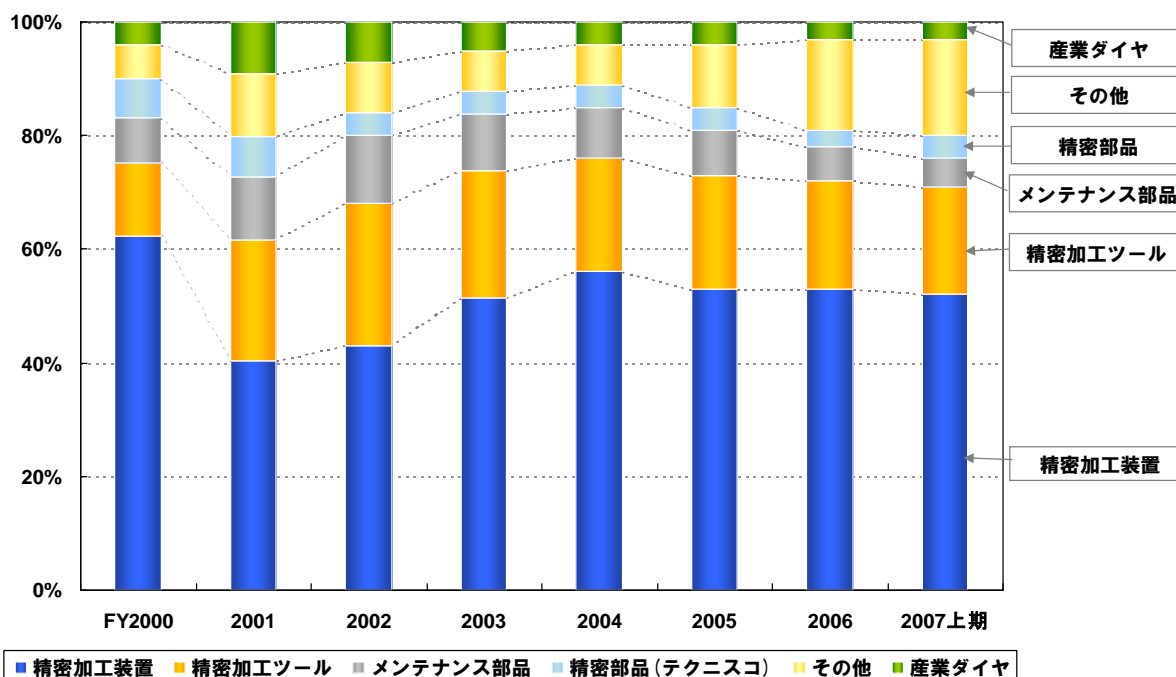


注:2000年度第3四半期より四半期決算開示

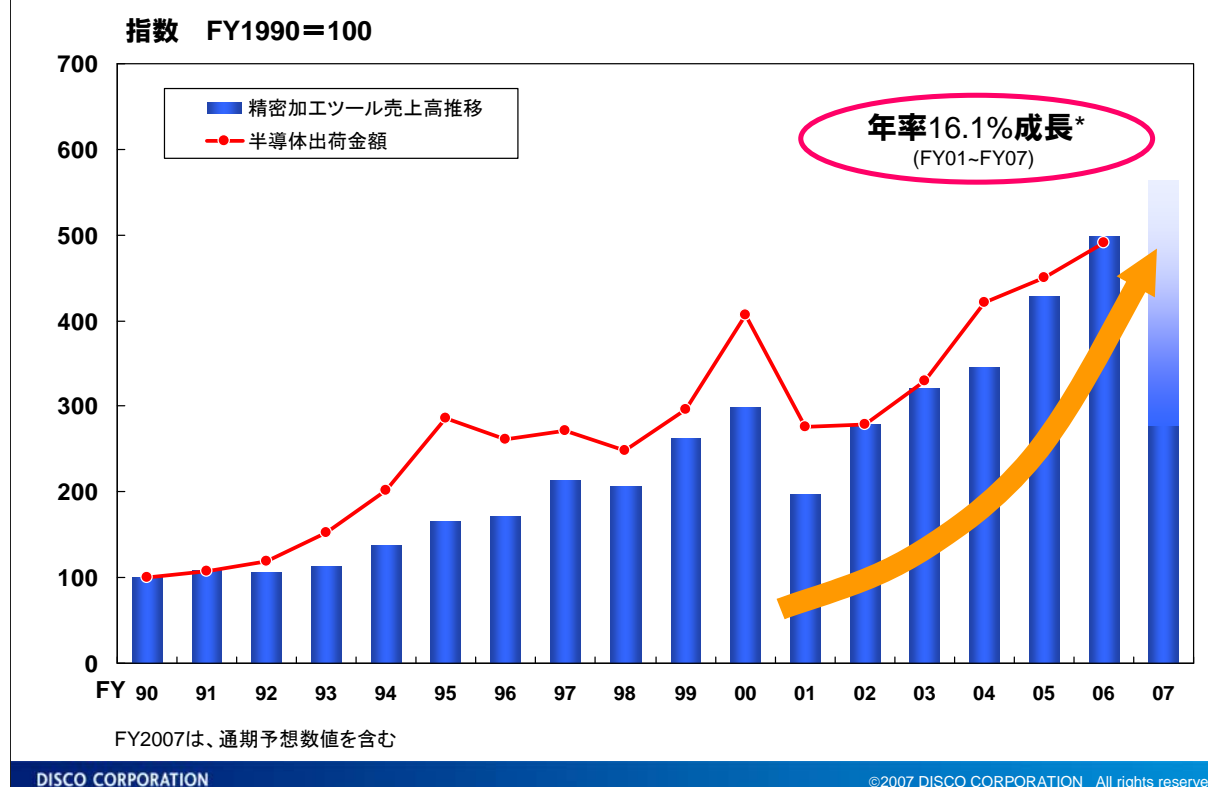
DISCO CORPORATION

©2007 DISCO CORPORATION All rights reserved

- 4月・5月の受注は主としてメモリ価格の急落の影響からメモリメーカーの投資の手控えもあって停滞していたが、6月以降急回復。そのため、第一四半期の売上は受注に追いつかなかったが、第二四半期において売上が受注を上回った。
- 第一・第二四半期は四半期ベースで過去最高の受注高を更新。消耗品に相当する精密ダイヤや、パッケージ向けの切断装置、素材ウェハ向けの研削装置等が高水準で推移して牽引要因となった。上期の受注も479億円と半期ベースでも過去最高を記録。
- 現在、足元の受注も順調に推移。



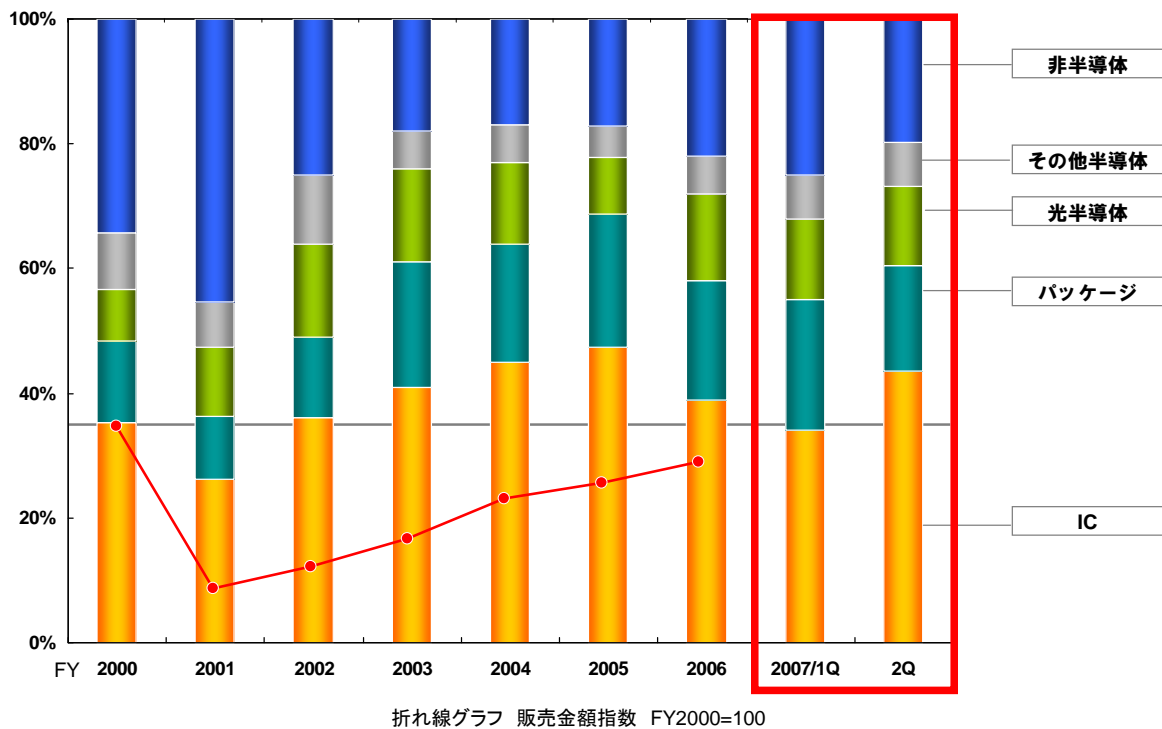
- 製品群別構成比では、ここ数年精密加工装置は50～55%前後、精密加工ツールは約20%と比率としては安定。実際の売上はともに伸張。
- 「その他」には薄化のシステムでグラインダポリッシャと併せて販売されるマウンタDFM2700がOEM商品として計上。この数年で半導体における薄化需要に対するニーズの高まりにあわせて「その他」の比率が伸張。



- 精密加工ツール（精密ダイヤモンド）の売上は好調。前下期をさらに上回り過去最高の記録を更新。同売上は半導体生産数量や電子部品数量の出荷増加に連動した動きを示す傾向が強く、足元の生産数量増加のトレンドにあわせて今期通期でも過去最高の記録を塗り替えると予想。
- 2001年度からの当社精密加工ツールの出荷金額の成長率は年率16.1%の成長。

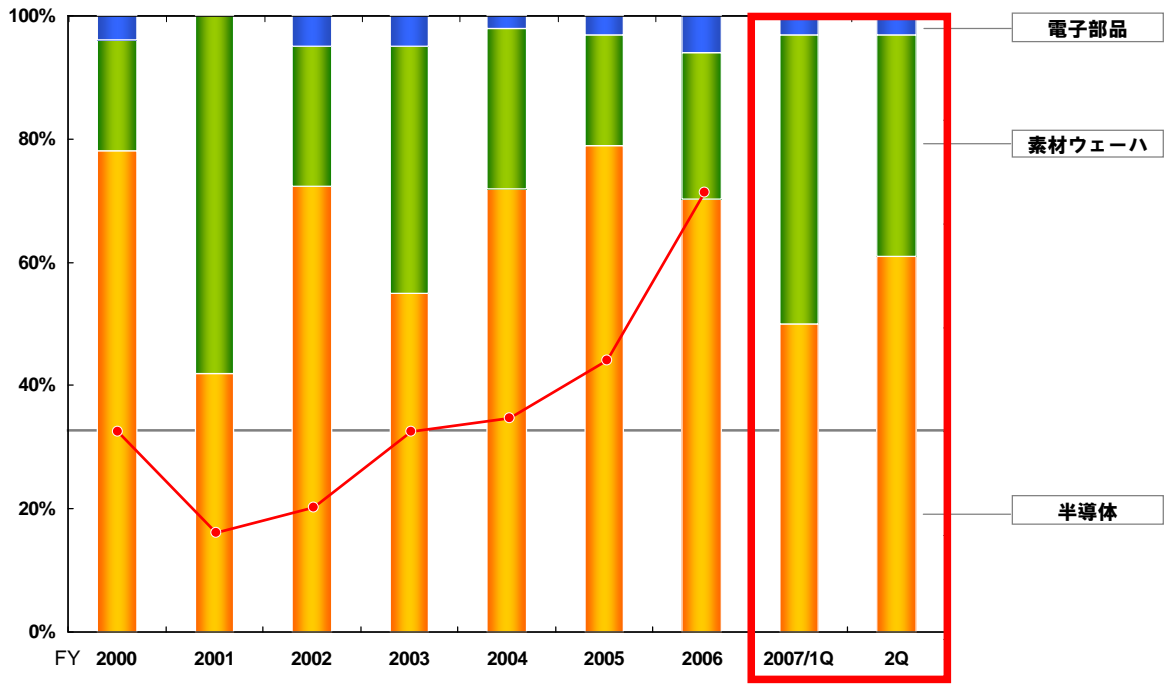
WSTS（世界半導体市場統計）が発表している2001年から2006年の半導体年成長率の10.7%を大きく上回っている。

ダイサ売上構成(アプリケーション別)



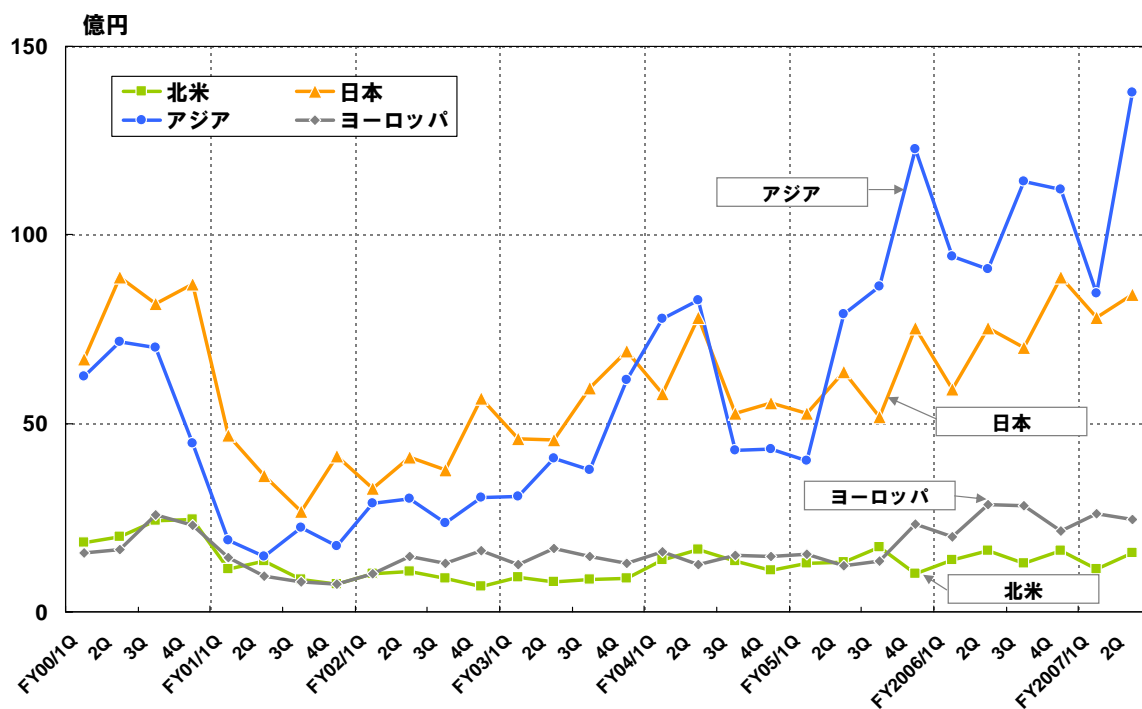
- 第一四半期ではメモリ関連投資の手控えの影響で、IC向けの比率が下がった。これは韓国・台湾地域が多くを占めているセグメントである。第二四半期はこれら地域の回復により、IC比率が大幅に改善。
- パッケージ向けダイサー、非半導体のダイサーともにIC比率改善のため、2Qでの構成比率が下がって見えるが、実際の売上は伸張。

グラインダ売上構成(アプリケーション別)



折れ線グラフ 販売金額指数 FY2000=100

- 半導体向けは第二四半期で薄化向けの用途が動き出している。
- 素材ウェーハ向けは300ミリウェーハの新規設備投資に伴い第一、第二四半期ともに好調。



- 日本市場は第一、第二四半期ともに堅調。
- アジア市場は第一四半期に韓国、台湾の出遅れの影響があったが、第二四半期で回復。
- 欧米は横ばいだが、開発拠点として重要な位置づけ。引き続き販売活動に注力。

バランスシート(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)	2006年度		2007年度	増減
	中間期末 (06年9月30日)	通期末 (07年3月31日)	中間期末 (07年9月31日)	2006年度末比
流動資産	682	758	731	-27
現預金	222	270	215	-56
受取手形・売掛金	252	278	304	26
棚卸資産	184	172	177	4
その他	24	38	35	-3
固定資産	365	380	445	65
有形・無形固定資産	305	345	379	34
投資その他の資産	60	35	66	31
資産合計	1,047	1,138	1,176	38
流動負債	245	288	282	-6
固定負債等	31	31	27	-4
株主資本等	771	819	867	48
自己資本比率 (%)	73.3%	71.5%	73.2%	1.7pt
負債純資産合計	1,047	1,138	1,176	38

- 現預金は法人税支払い（今中間期50億円）、配当金支払い（同15億円）、有形固定資産の取得による支出（同30億円）、40億円の定期預金設定による支出（同40億円）等の主な支出と、純利益や減価償却費等の収入の出入りの結果、前期末比55億57百万円減少。
- 流動負債の増加要因（前年同期比）の主なものは呉工場、桑畑工場の建築工事費の延払い費用が主なもの。
- 自己資本比率は73.2%。前期末の71.5%から上昇。業界変化（シリコンサイクル等）に備えるため、積極的なR&D投資を手元資金で賄ってゆく観点からも高くキープしたい考えである。

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)

	2006年度 中間期	2007年度 中間期	2006年度通期 (12ヶ月)ご参考
営業キャッシュフロー	44	33	132
税前純利益	93	110	177
減価償却費	14	15	30
売上債権・棚卸資産・仕入れ債務	-21	-31	-29
法人税等の支払額	-37	-50	-65
その他	-5	-12	18
投資キャッシュフロー	-37	-61	-89
有形固定資産の取得による支出	-10	-31	-49
定期性預金の預入による支出・収入他	-27	-30	-40
財務キャッシュフロー	-15	-19	-24
有利子負債の減少	-3	-3	-3
親会社による配当金の支払額	-12	-15	-22
その他	-1	-1	1
フリーキャッシュフロー	7	-27	42
現金および現金同等物の増加額	-7	-46	20
現金および現金同等物の中間(期末)残高	212	195	240

- 営業キャッシュフローは、純利益の増加、棚卸資産の増加等により、33億33百万円の収入。
- 投資キャッシュフローは、定期性預金の預け入れによる支出40億円、同満期償還10億円、有形固定資産の取得による支出で30億90百万円により、60億62百万円の支出。
- 財務キャッシュフローは配当金の支払い15億28百万円、短期借入金返済3億による支出で18億79百万円の支出。
- この結果、現金および同等物の残高は前期末比45億57百万円減少の194億88百万円。

(単位: 億円 四捨五入)	中間期	下期予想	通期予想 (11月13日)	【ご参考】 2006年度 通期	対前年比
売上高	461	510	972	861	12.8%
営業利益	110	109	219	195	12.2%
営業利益率	23.9%	21.3%	22.5%	21.9%	0.6pt
経常利益	110	109	219	197	11.4%
経常利益率	23.9%	21.4%	22.6%	22.8%	0.2pt
当期純利益	62	66	128	109	17.0%
純利益率	13.4%	13.0%	13.1%	12.7%	0.4pt

(連結売上高と利益見通し)

通期売上高は過去最高を更新する972億円を予想、営業利益から当期純利益まで過去最高の更新を見込む

(法人税関連)

- ・当中間期 : 子会社清算にかかわる繰延べ税金資産の取り崩し 5億円計上
- ・今下期に上記清算計画確定に伴う同上繰延べ資産の再計上(5億円)を見込む

(特別損失)

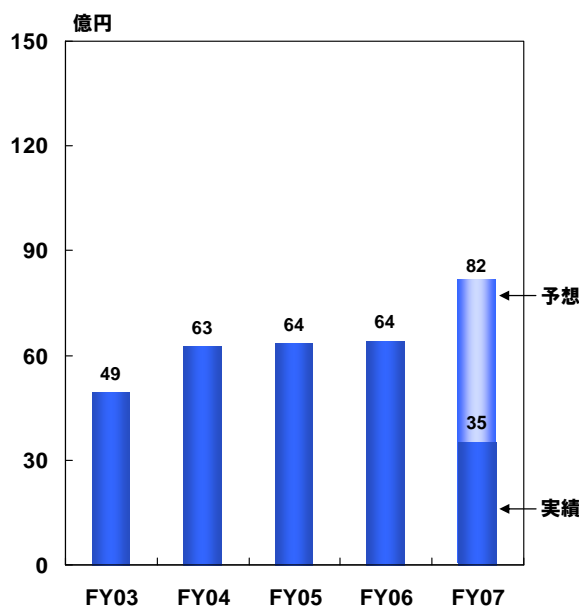
- ・棚卸資産評価損3億円 低価法対処1億円の合計4億円を下期に見込む

(為替前提)

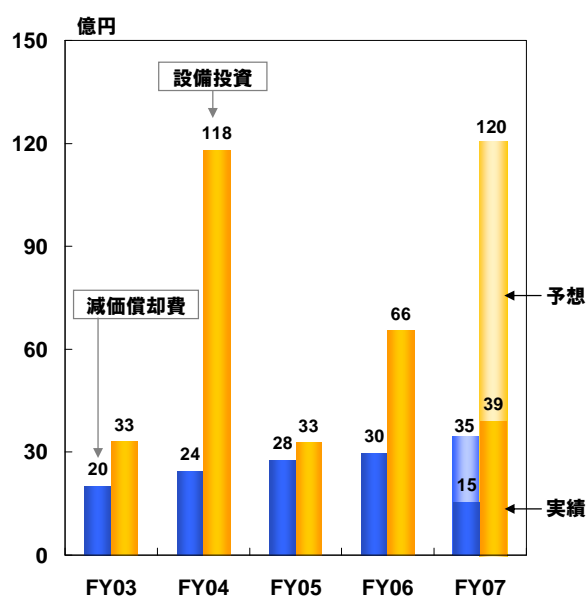
US\$: 115円/EUR:155円/SGP\$:70円

- 下期において、PC、携帯電話、薄型テレビなどの好調による半導体需要の増加、新規の設備投資が予測され、通期見込みを上方修正。上表の通り。
- 下期見込みには特損4億30百万円を含む。内訳は在庫廃棄、低価法導入による損金等。法人税は前述の通り、繰延べ税金資産の再計上を計画。
- 個別実績は、短信記載の通り。

研究開発費



減価償却費・設備投資



- 研究開発費用は83億円（前回発表）から微調整し、82億円を想定。通期計画に対する上期の進捗率は43%であるが、開発要員の採用なども順調に進捗。計画通りに研究開発費用の遂行がなされると想定。
- 設備投資は前回発表の102億円から120億円に増額。減価償却は34億円から35億円に微調整。

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当

関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長

溝呂木 齊

3. 質疑応答

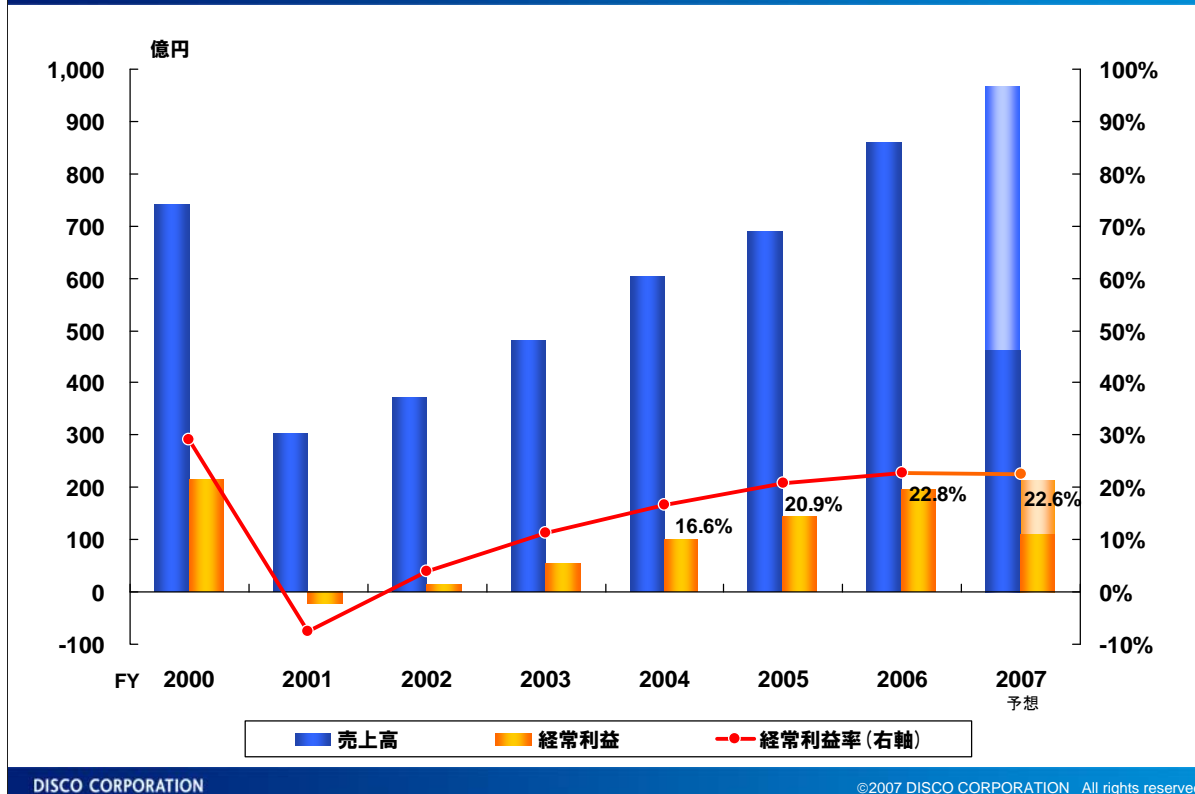
プレゼンテーション

代表取締役社長 溝呂木 齊

事業の展開について

(要旨)

当社の事業展開について、「製品の構成」や「技術開発」の事例を紹介すると同時に、それらを支えるディスコの「経営構造」の概略について説明する



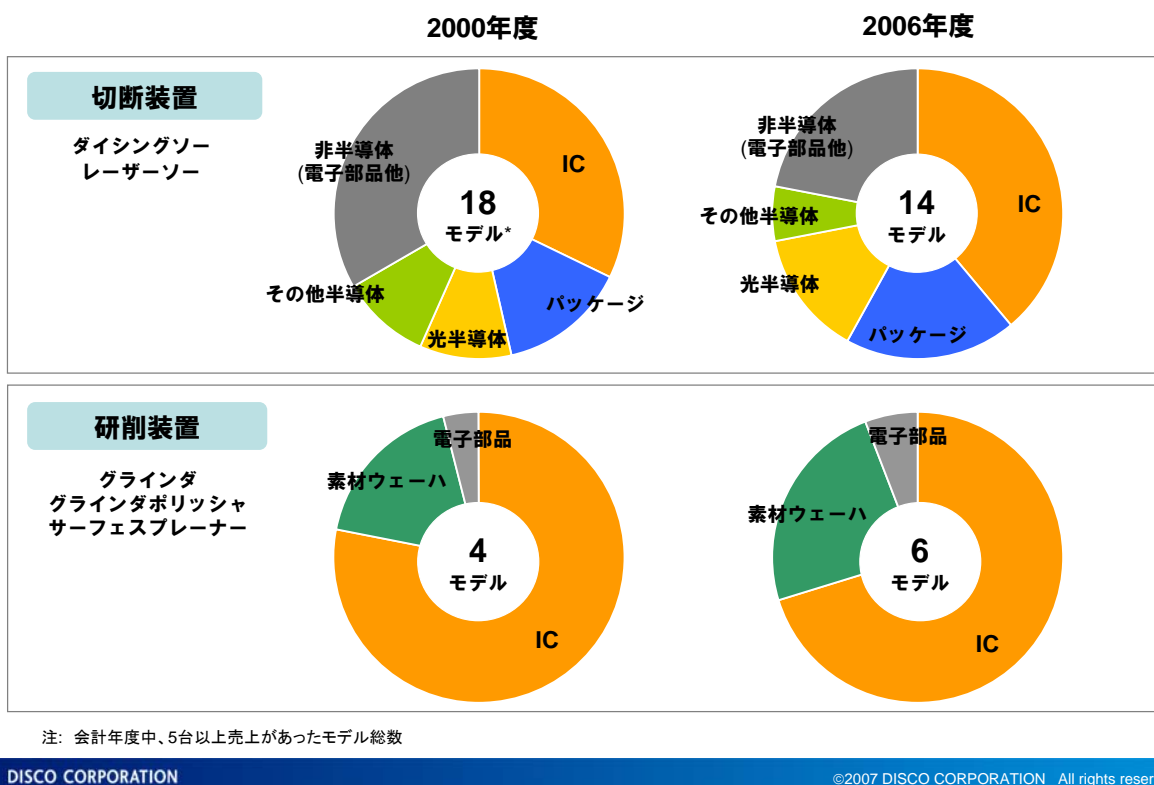
DISCO CORPORATION

©2007 DISCO CORPORATION All rights reserved

- 2001年度はITバブル崩壊後の最悪の状態から、6年間順調に回復。
その理由として、
 - ① 技術変化などの環境に恵まれた
 - ② 2001年の最悪の状態から多くを学び, 変化に「強い現場作り」を実践
 - ③ 企業の質の向上を図るために行った施策が功を奏し、利益に結びついてきたこと等が上げられる。

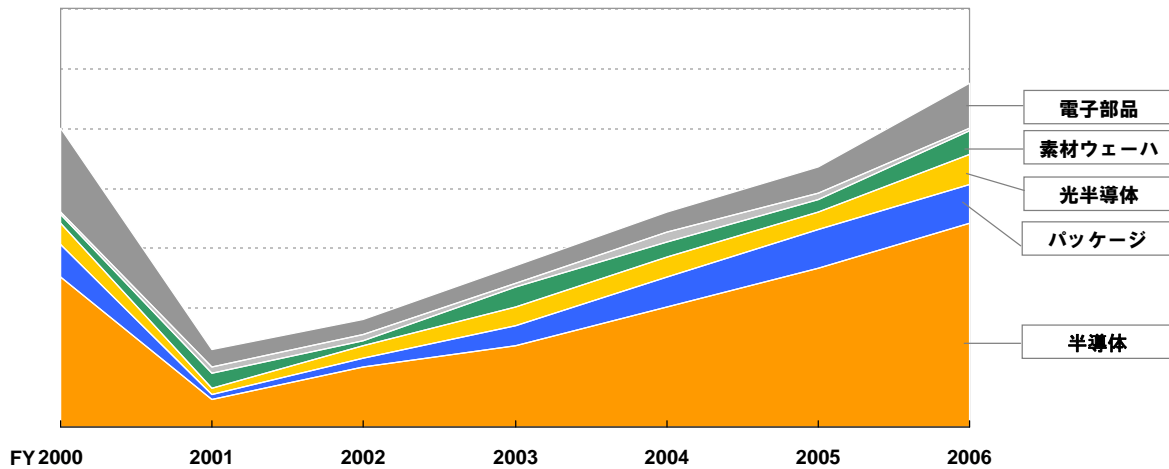
- 近年はDISCO VISIONとして目標としてきた経常利益率20%以上を確保し、将来への投資を積極的にする体制が出来ていることも大きい。

- 07年度も、生産工場の能力増強やR&Dセンター新棟建設などの積極的な投資を実施。



- 00年度と06年度の比較では、売上・利益を構成する内容が変わってきている。
その変化のポイントとして以下のような背景があると考えている。
 - ・半導体の加工に関与する当社の事業機会 (KKM/切る・削る・磨く)が増えていることである。
- こうした変化が、当社の事業構成のなかでアプリケーションに幅を生んできた。
- そのような変化に対応しながら、上図のようにダイシング (切断装置) は、モデル数を絞り、1モデル当たりの生産効率性 (単位あたりの売上金額の増加) をより高めてきた。
- レーザーソー (切断装置) も実績が上がってきており、光半導体 (LED向け等) などでの用途拡大も進展。
- グラインダーでは薄化装置と素材ウェーハも順調に進展。売上構成でもウェイトを増しており、用途の拡大につながっている。

アプリケーション別 装置売上推移



- 電子部品は2000年の水準を越えず
- 半導体向けは、薄化・ストレスリリーフ用装置が牽引
- パッケージシンギュレーション・素材ウェーハなど、ディスコならではのアプリケーションを提供し、着実に売上規模が拡大

●上表は、2000年度当時と比較して、時系列でみて明らかにKKM（切る・削る・磨く）の事業領域が拡大してきていることを示したものの。

●電子部品の売上規模は2000年のITバブルの水準はまだ超えていないが、それ以外の全てのアプリケーションで2000年当時の水準を上回っている。

【装置】

DFD6240	DAD3000シリーズ	DFD6450	レーザ DFL7000シリーズ
薄化 DGP8760+DFM2700	DFS8910	薄化 DFE8040/8060	
DFM2700 DGP8760		DFE8060 DFE8040	

【プロセス】

薄化 エッジトリミング	超音波ダイシング	薄化 TAIKOプロセス	エッジプロファイリング
	Water Jet Saw	レーザ DAFレーザーカット	レーザグルーピング

【精密加工ツール/消耗品】

ZH05	薄化 Poligrind	Stay Clean-F	ZP07

2003

2004

2005

2006

●具体的な技術開発の状況を時系列で見ても、装置開発だけではなく、超音波技術や、TAIKOなどの新規プロセスや消耗品などの開発も積極的に行っていることを理解していただけたらと思う。

DFL7340/7360



- 浜松ホトニクスと提携し、ステルスダイシング技術を利用したレーザーソー

DFL7260



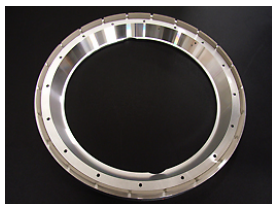
- 2つのレーザーヘッドが搭載可能
- Low-kグルーピング+シリコンフルカットなど多様なアプリケーション

DFD6362



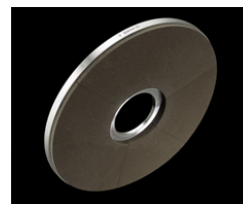
- 300mm量産用ダイサーDFD6361の生産性を更に向上
- 無人化・高稼働率を可能にするAuto Blade Changer (ABC)を搭載可能

UltraPoligrind



- 50μm厚以下のウェーハ薄化をターゲットとし、ゲッターリング効果を十分に得ながら、チップ強度も維持するストレスリリース工程における新たなソリューション

DP08

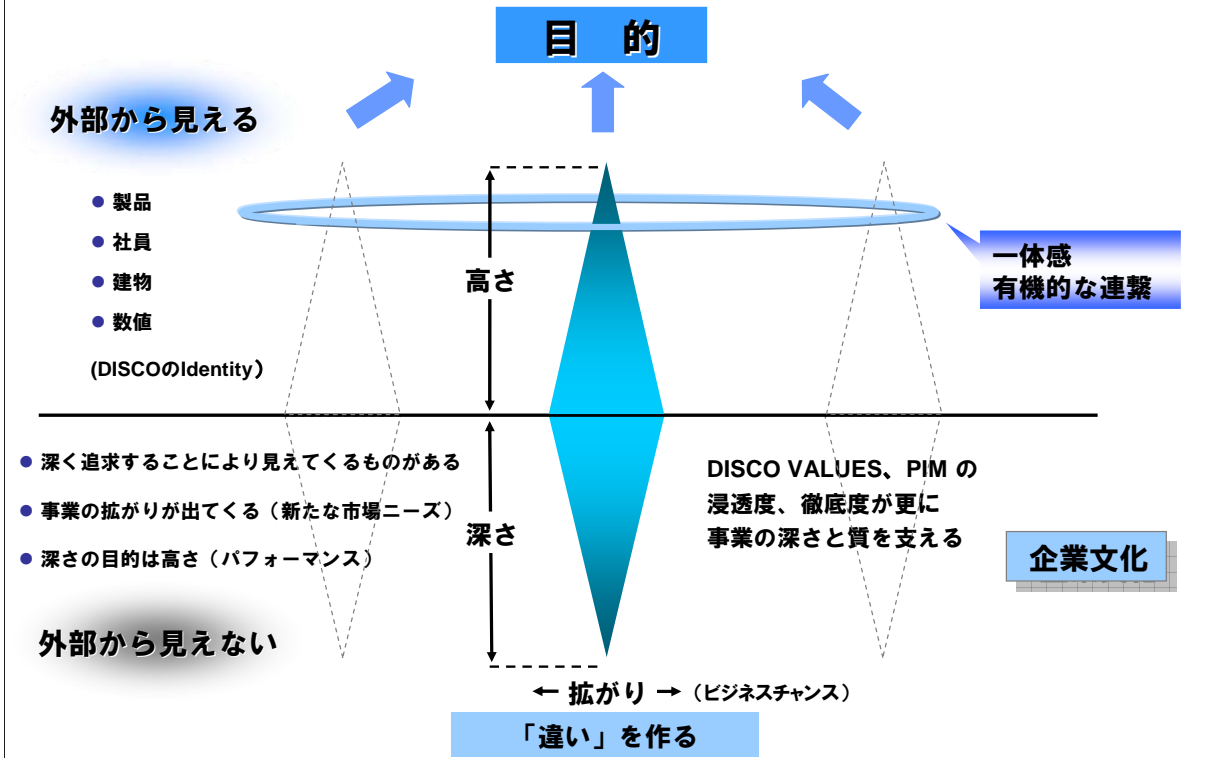


- ケミカルフリーでストレスリリースを実現するドライポリッシングホイール
- DBGプロセスとの融合も可能

- 今年、セミコンジャパンを前に新製品のプレスリリースを行っているもの示している。
- レーザーについては、浜松ホトニクス様と提携し、ステルスダイシングの技術を得たことによって、溝入れ（グルーピング）、フルカットと併せて、主要なレーザー加工技術がそろった。
- 「ウルトラポリグラインド」は、ストレスリリースを行い、完全に破碎層が除去されるとゲッターリング効果がなくなってしまうので、抗折強度を維持しながら、ゲッターリング効果がある研削ができるように開発したものである。
- これらの製品展開によって新たなビジネス機会の広がりが生まれることを期待している。

トータルソリューション(顧客の認める価値)





今期の見通しについて

(単位: 億円 四捨五入)	中間期	下期予想	通期予想 (11月13日)	【ご参考】 2006年度 通期	対前年比
売上高	461	510	972	861	12.8%
営業利益	110	109	219	195	12.2%
営業利益率	23.9%	21.3%	22.5%	21.9%	0.6pt
経常利益	110	109	219	197	11.4%
経常利益率	23.9%	21.4%	22.6%	22.8%	0.2pt
当期純利益	62	66	128	109	17.0%
純利益率	13.4%	13.0%	13.1%	12.7%	0.4pt

- 通期業績予想については先ほど常務からも説明した通り。前回発表値から上方修正を行い、売上高から当期純利益まで過去最高の更新を見込んでいる。

薄化・ストレスリリーフ装置



- メモリーメーカーの投資の手控えもあり、DGPは当初の期待よりも伸びず
- サブコンは薄化用装置の設備投資を活発化
- アプリケーション開発を積極的に行い、高度化する技術ニーズへ対応

レーザー



- Low-kグルーピングの他、LED向け化合物半導体切断用途も拡大の傾向
- 台湾等サブコン向けにも需要拡大
- ダイシングソーで培ったノウハウを活かし、幅広い顧客層へ展開中

生産効率とBCM対応力向上をめざした設備投資を実施



桑畑工場 精密加工装置及び加工ツールの製造	
投資総額	100億円
着工予定	2008年7月
完成予定	2009年夏
目的	製造現場の集約による効率向上 将来の需要拡大へ対応するための 先行投資 BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造

茅野工場 子会社ダイイチコンポーネンツ製造工場	
投資総額	25億円
着工予定	2008年7月
完成予定	2009年夏
目的	作業効率の向上 BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造

- 来年着工開始で、桑畑工場と茅野工場の新規投資を予定。主眼は生産効率の改善とBCM（事業継続管理：Business Continuity Management）対応の向上を目指したもの。
- また地震等の災害時にも、供給責任者としての当社の量産体制に支障が出ないようにするために免震構造を採用。

	中間期	期末	記念配当	年間
2008年3月期(予想)	35円	41円	-	76円
(ご参考) 2007年3月期(実績)	30円	35円	10円	75円

【配当方針】

- ①連結業績に連動した配当（配当性向20%）
- ②安定配当として最低20円の配当金を維持。
ただし3期連続で連結純損失の場合を除く。
- ③赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額^(*)を超過した場合は、上記①に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せする

【注】2007年3月期末時点予定必要資金額 300億円
現預金残高が予定必要資金額を超過しないため配当金の上乗せはなし

- 最後に、当社の配当について。今中間期は5円増配の35円。また通期業績予想の上方修正によって期末配当は41円、年間で76円を予定。
- 昨年は記念配当10円があったが、それを含めても昨年度対比で増配を予定している。

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当 関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長 溝呂木 齊

3. 質疑応答

DISCO
Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



DISCO CORPORATION